

# Gudeng Precision Industrial Co. Ltd

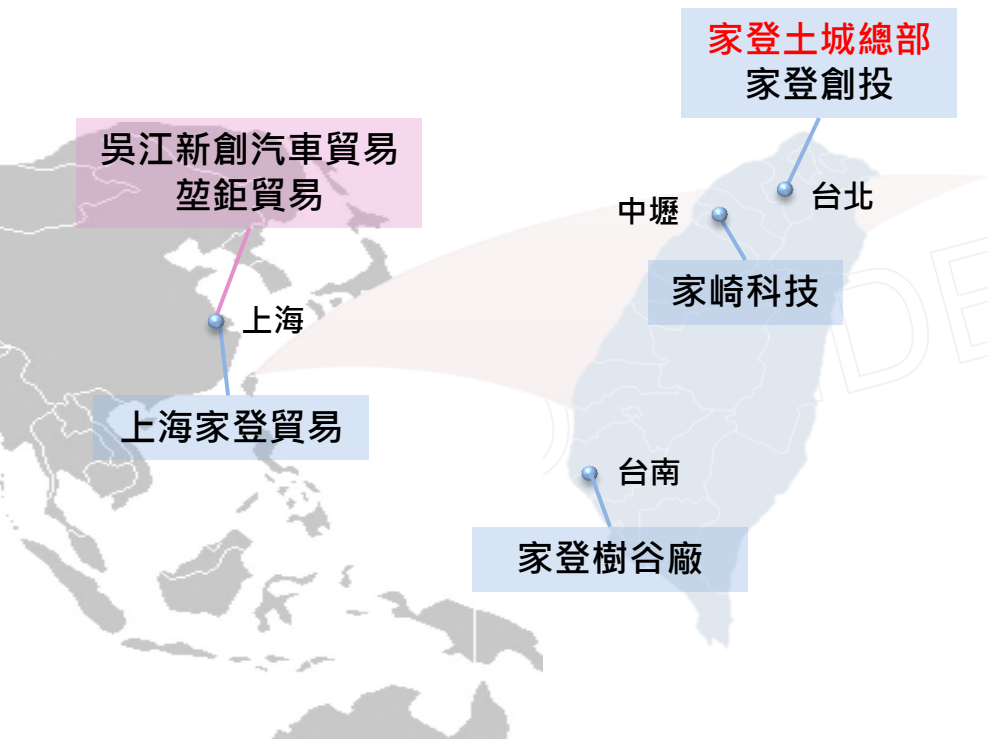
## 家登精密工業股份有限公司



2021.03.19  
邱銘乾 董事長

Partner with H.E.A.R.T. , Grow with P.A.S.S.I.ON.

# 家登簡介



- 成立於：1998年3月20日
- 員工數：460 (TW) /70 (CH)
- 實收資本額：NT 836,586,120
- 集團2019營業額：NT 23.7億元
- 集團2020營業額：NT 25 億元
- 主力產品：

## 半導體事業

- ① 光罩傳載解決方案
- ② 晶圓傳載解決方案
- ③ 半導體機台設備
- ④ 其他服務

## 汽車事業

- ① 整車銷售
- ② 零組件銷售
- ③ 售後服務

# 顧客分佈



- 顧客所在地
- 家登美國辦公室

家登美國辦公室  
2020.02 成立

Intel、IBM  
GLOBALFOUNDRIES  
G450C、Micron、  
WAFERTECH、Veeco

Infineon、AMTC  
TEC-SEM、Osram  
GLOBALFOUNDRIES  
Tower Jazz、ST Micro

SMIC、Hejian  
TSMC、GSMC、  
UMCX、PDMCX、  
Intel、JHICC

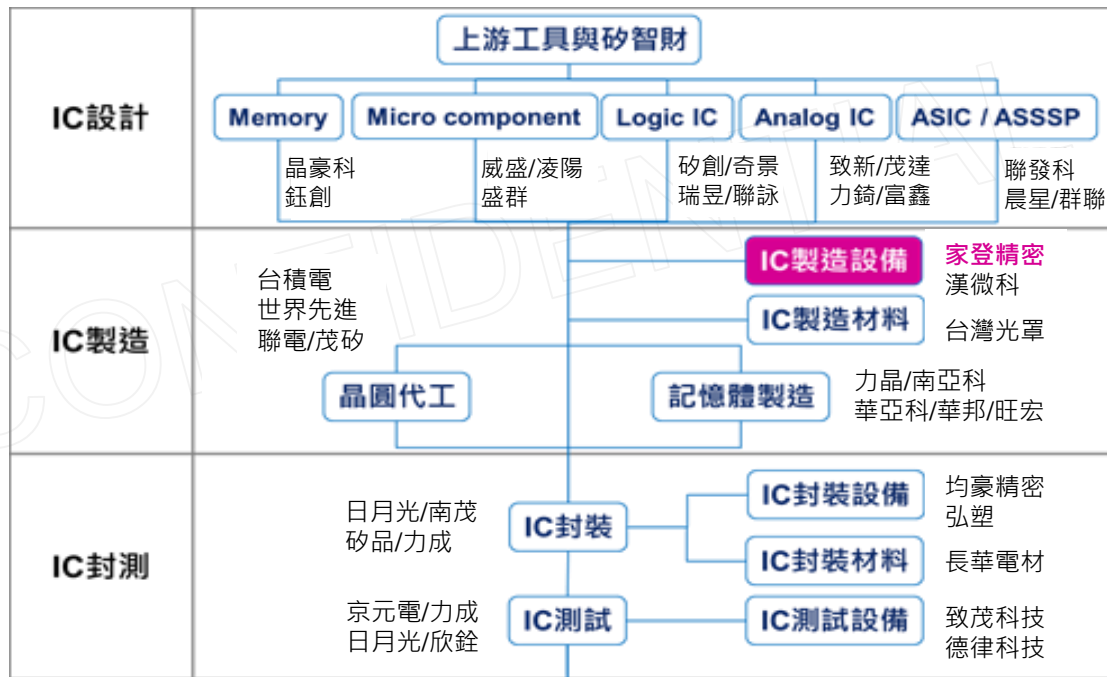
GLOBALFOUNDRIES  
SSMC、UMC12i  
Micron

Samsung  
Hynix  
Toppan  
Megnachip  
PKL  
Nepco  
FST

TSMC、UMC  
TMC、PDMC、TCE  
VIS、ASE、SPIL  
NSP、Micro、  
Powerchip、Winbond

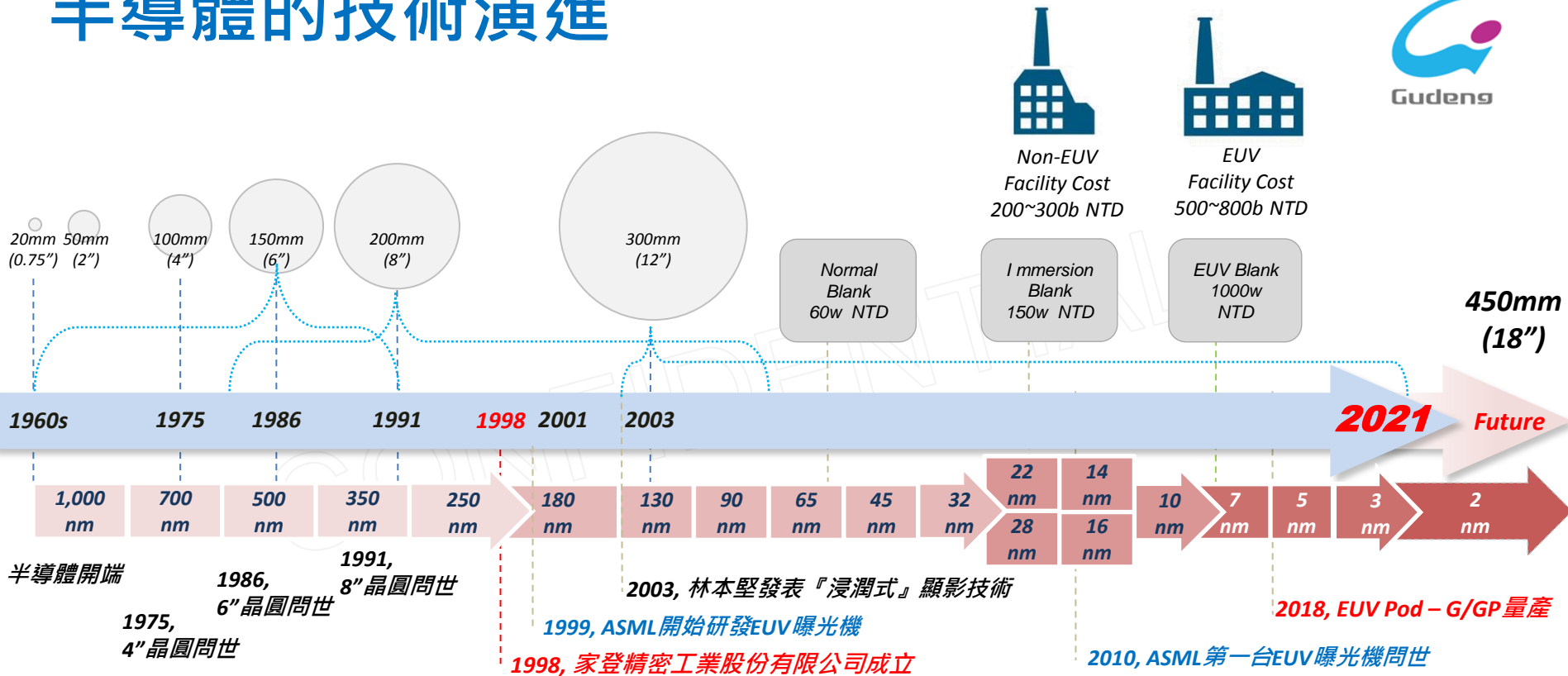
Toshiba  
SONY  
CANON  
SCREEN  
Daifuku  
Murata  
Fujitsu  
Hoya  
Toppan

# 半導體產業供應鏈



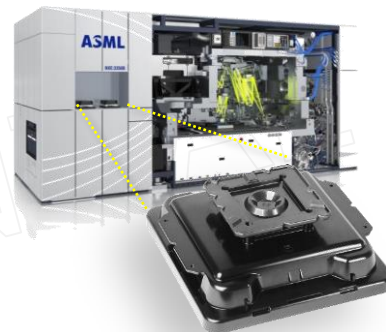
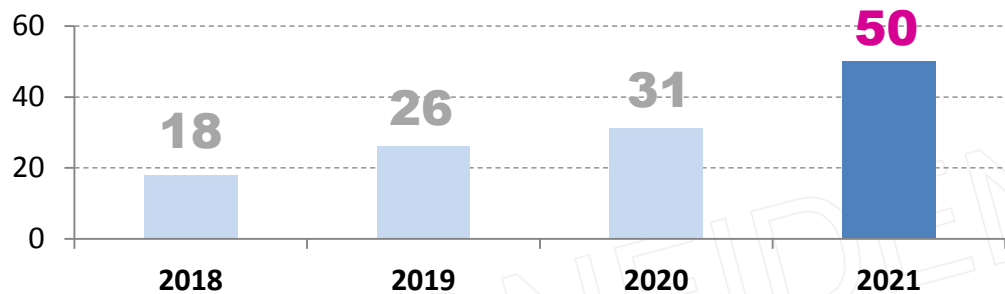
未來願意採用EUV技術的IC設計公司數量  
決定家登營收成長趨勢

# 半導體的技術演進



# 半導體的技術演進

## ASML EUV Scanner Shipment



EUV layers  
EUV Pod Demands



**EUV Layers UP**



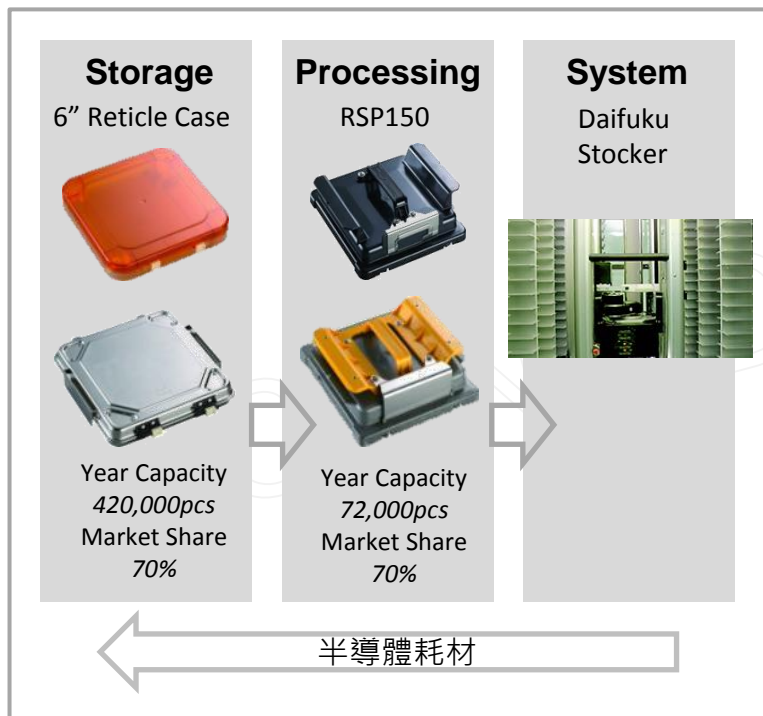
Samsung  
Hwaseong



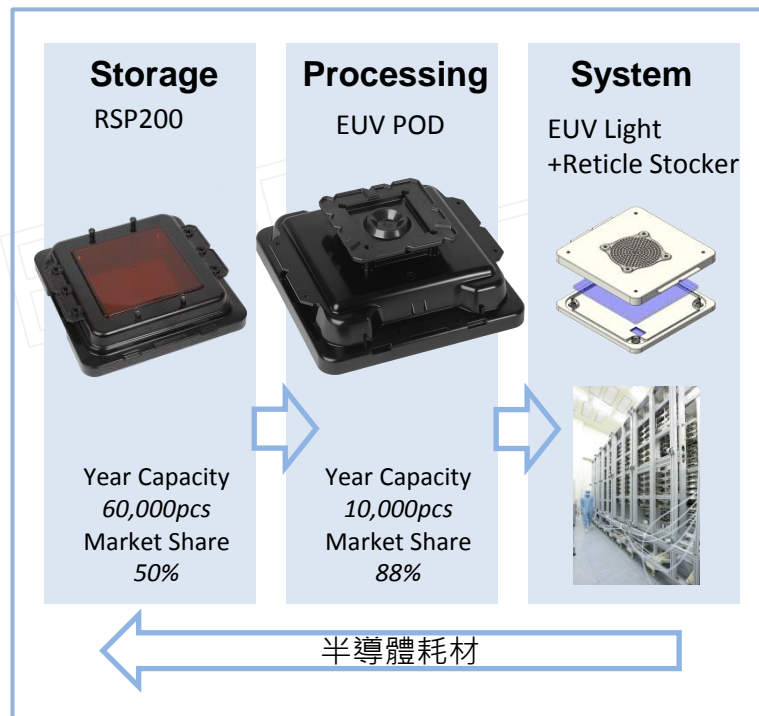
TSMC P18

# 家登載具布局

## Immersion



## EUV EUV Total Solutions





# 半導體產品範疇

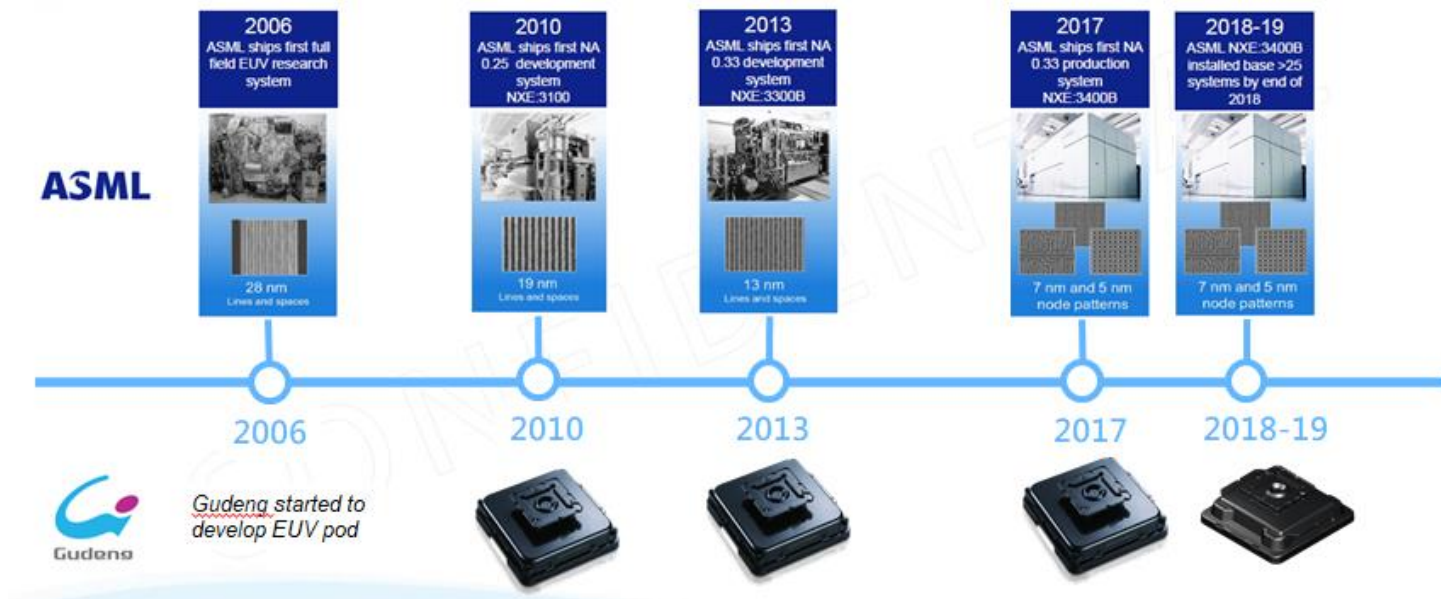
## 光罩傳載解決方案

- ▶ 極紫外光光罩傳送盒(EUV POD)
- ▶ 光罩盒系列
- ▶ 光罩傳送盒系列
- ▶ 標準機械介面(SMIF)高階光罩傳送盒系列



世界唯二 台灣唯一

# 家登 EUV Pod 發展史



*Our EUV journey so far....*

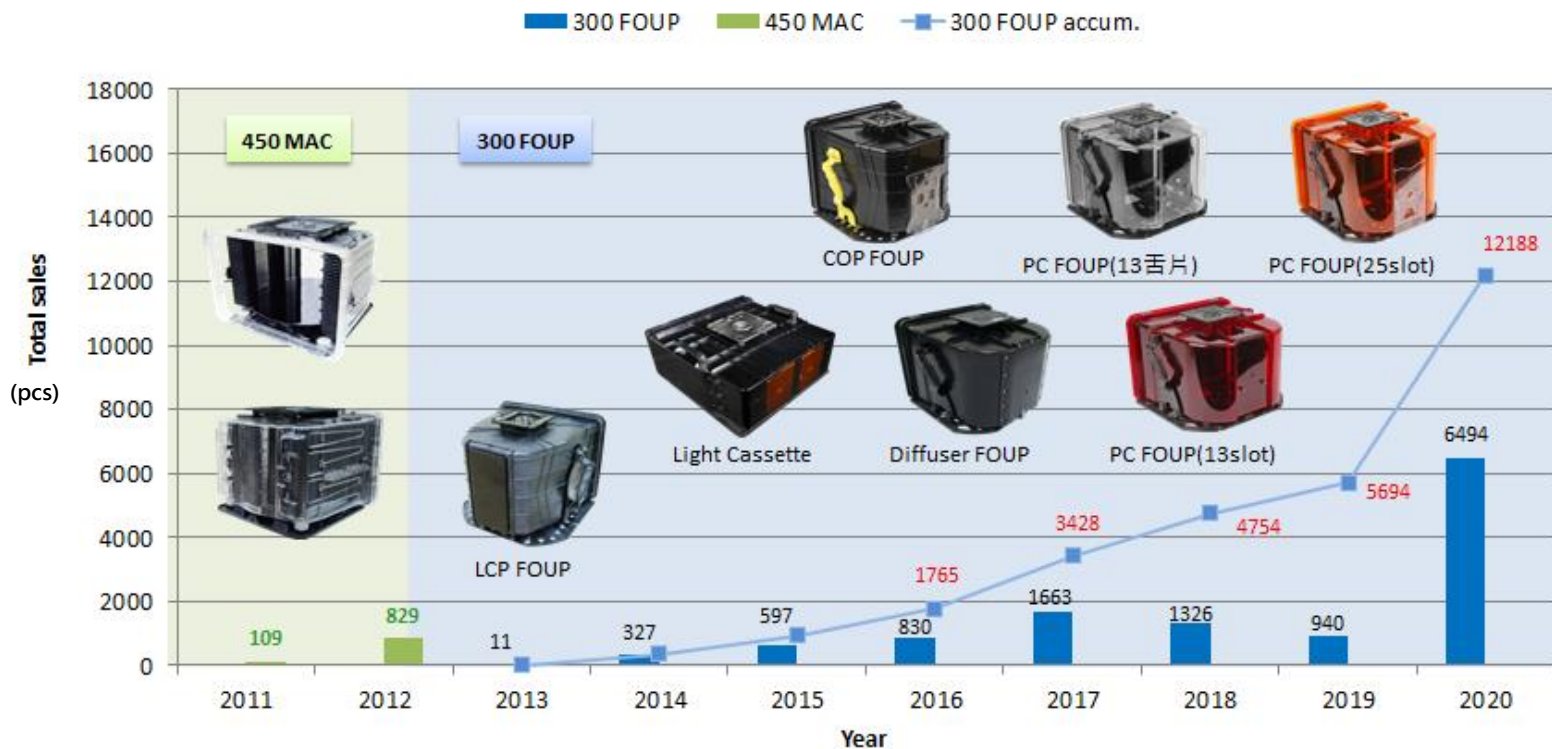
*> 10 years to develop EUV technology with our customers.*

## 晶圓傳載解決方案

- ▶ 18吋前開式晶圓傳送盒(450mm FOUP)
- ▶ 18吋多功能應用晶圓傳送盒(450mm MAC)
- ▶ 12吋前開式晶圓傳送盒(300mm FOUP)
- ▶ 其他晶圓盒系列

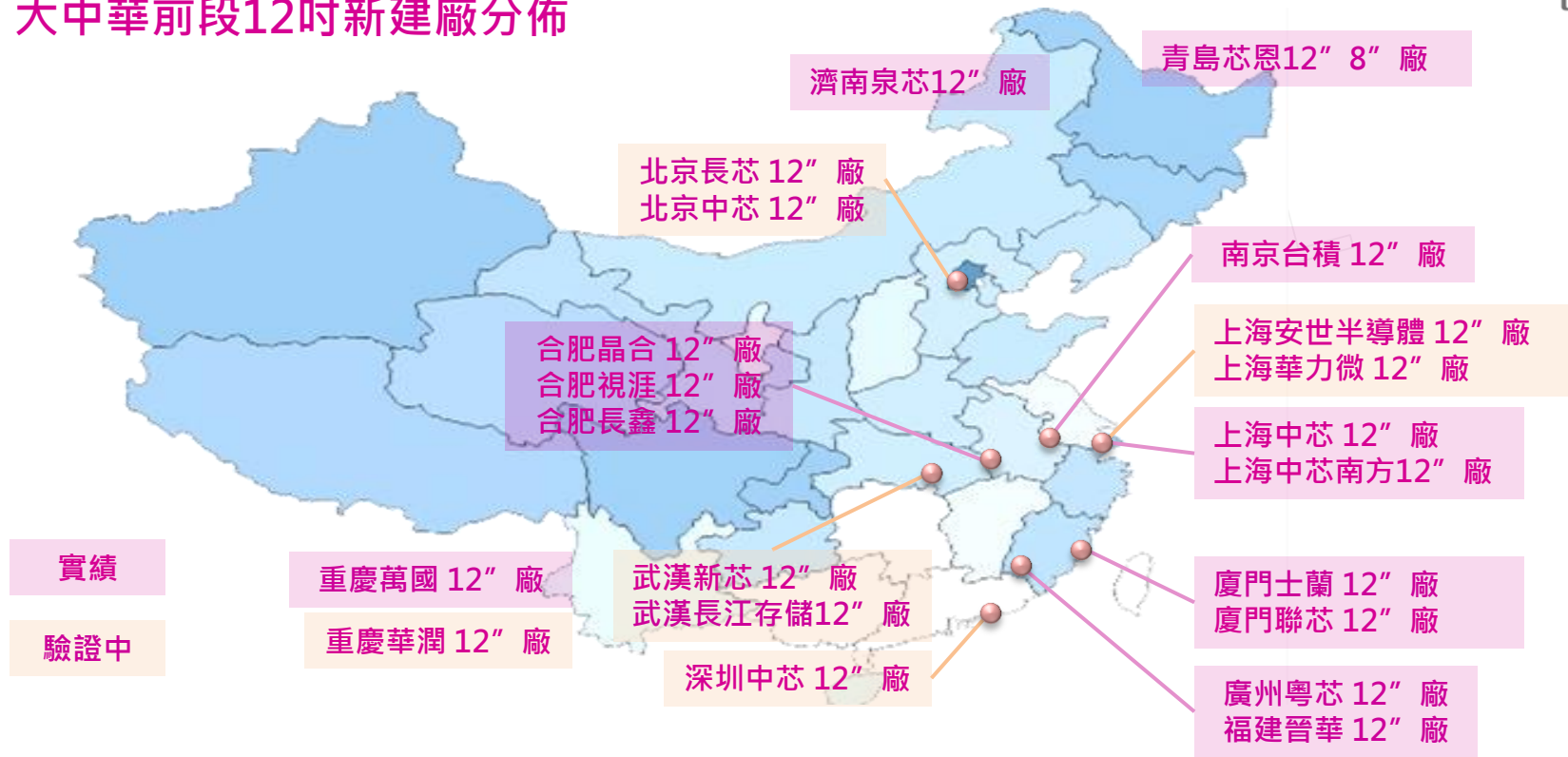


# 家登 FOUP 發展歷史



# 大中華半導體產業市場機會

## 大中華前段12吋新建廠分佈



實績

驗證中



# 大中華半導體產業市場機會



## 大中華8吋廠新建廠以外客戶分佈

### ■ 後段封測

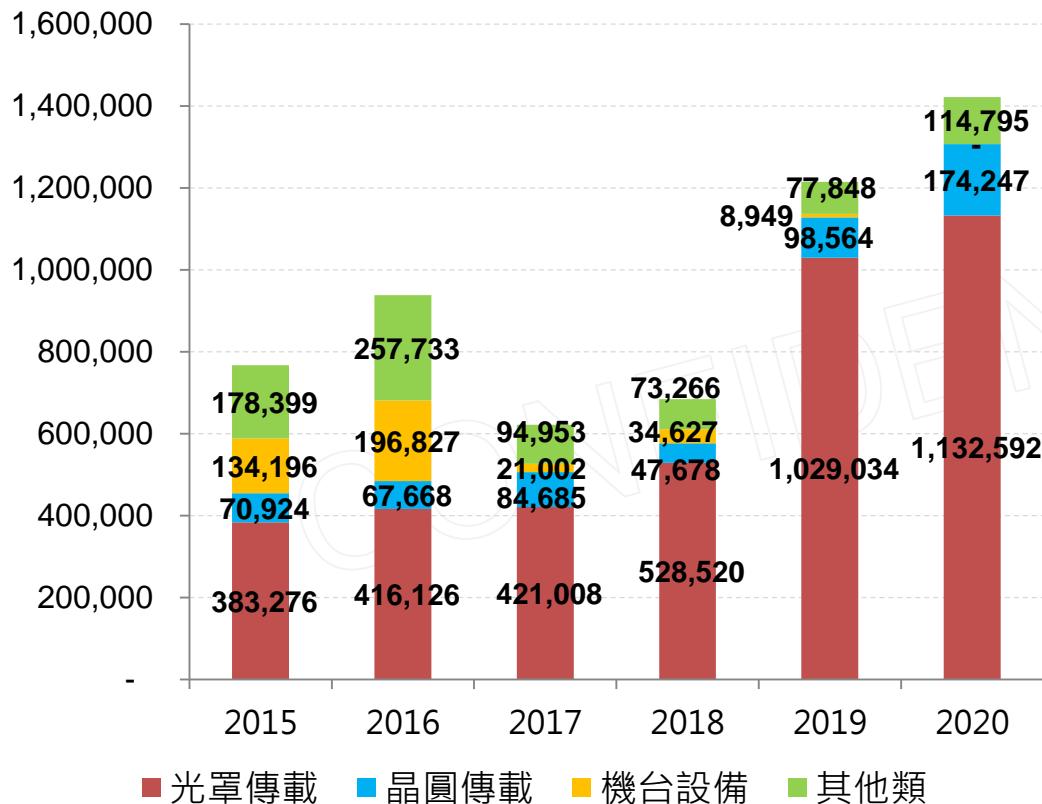
- 江陰長電
- 長電紹興
- 南京芯德
- 華天科技
- 通富微電

### ■ 國產設備商

- 曝光機製造商  
上海微電子
- 蝕刻機製造商  
北方華創



# 半導體事業營運展望-產品別



## 光罩傳載：

深耕既有市場，緊跟極紫外光微影製程拓展腳步，主推極紫外光光罩傳送盒(EUV Pod)。

## 晶圓傳載：

開發新市場，以領導技術搶入12吋晶圓市場，主推12吋FOUP。

## 其他：

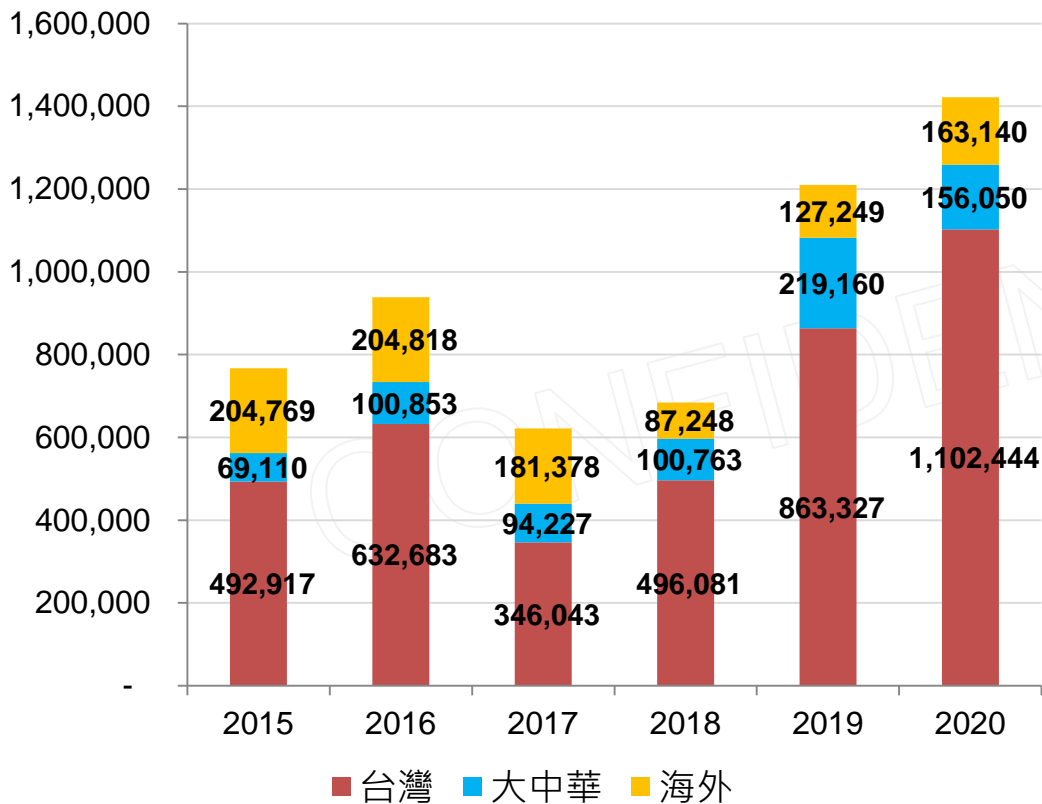
與策略夥伴攜手，進入濾芯 / 晶圓 / O-ring 等耗材市場。

2016.8月家登自動化子公司成立，完全承接機台設備之業務。

2021下半年期待航太類營收挹注。

單位：新台幣仟元

# 半導體事業營運展望-地區別



## 台灣地區：

客戶夥伴關係深厚，看好台灣半導體產業鏈之完整性與國際重要性，持續擴大領先優勢，以完整的服務與優異產品品質深耕市場。

## 海外地區：

除半導體三大領導廠，越來越多客戶評估採用 EUV 技術，家登光罩類產品海外市佔逐步攀升。

## 大中華地區：

進入半導體產業快速成長期，各大晶圓代工廠積極搶入，資本支出大增將帶動晶圓傳載與機台設備之需求，8吋及12吋市場為主力。

單位：新台幣仟元



# 策略與展望



## □ 發展高營收市場 Targeting High-Revenue Market

- ✓ 高階製程載具市場
- ✓ 半導體耗材新產品市場
- ✓ 航太關鍵零組件

## □ 精實生產、智慧製造 Lean Production, Intelligent Manufacturing

- ✓ 完善製造資訊系統，落實智慧製造

### 光罩載具

EUV POD版圖持續擴張，擴散領先優勢至海外  
RSP系列載具聚焦大中華/海外市場

### 晶圓載具

高低階晶圓載具全面搶攻台灣市佔  
12吋/8吋載具足跡擴遍大中華市場

### 航太零組件

建構完整產線、提升產能  
取得客戶長期訂單挹注營收



Thank You

[www.gudeng.com](http://www.gudeng.com)